公司代码:688233　　公司简称:神工股份

锦州神工半导体股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	神工股份	688233	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	常兆	宋梦施
电话	+86-416-711-9889	+86-416-711-9889
办公地址	辽宁省锦州市太和区中信路 46 号甲	辽宁省锦州市太和区中信路 46 号甲
电子信箱	info@thinkon-cn.com	info@thinkon-cn.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,105,959,630.88	2,083,316,926.92	1.09
归属于上市公司股东的净资产	1,909,221,191.41	1,890,097,190.33	1.01
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	216,405,628.20	208,527,693.79	3.78
利润总额	46,482,309.77	63,849,458.17	-27.20
归属于上市公司股东的净利润	41,085,379.13	48,837,928.66	-15.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,687,650.38	47,989,908.96	-21.47
经营活动产生的现金流量净额	134,124,129.75	67,507,435.15	98.68
加权平均净资产收益率(%)	2.15	2.69	减少 0.54 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.29	-17.24
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.29	-17.24
研发投入占营业收入的比例(%)	7.88	5.38	增加 2.50 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)							18,420
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
矽康半导体科技(上海)有限公司	境内非国有法人	20.87	35,560,301	0	0	无	0
更多亮照明有限公司	境外法人	19.73	33,600,481	0	0	无	0
中国银行股份有限公司-易方达信息产业革灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.78	4,733,234	0	0	无	0
温州瑞融企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.52	2,593,675	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金	其他	1.37	2,335,532	0	0	无	0
长江证券股份有限公司-华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.20	2,051,487	0	0	无	0
广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.15	1,955,237	0	0	无	0
中信银行股份有限公司-永赢先锋半导体智选混合型发起式证券投资基金	其他	1.06	1,800,000	0	0	无	0
王萍	境内自然人	0.85	1,453,462	0	0	1,453,462	无
上海珏明资产管理中心(有限合伙)-珏明惊帆多策略一号私募证券投资基金	其他	0.75	1,270,103	0	0	1,270,103	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	矽康半导体科技(上海)有限公司、温州瑞融企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区旭捷投资管理合伙企业(有限合伙)已签署一致行动协议。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688233　　证券简称:神工股份　　公告编号:2026-044

锦州神工半导体股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《锦州神工半导体股份有限公司募集资金管理办法》的规定,将锦州神工半导体股份有限公司(以下简称本公司或公司)2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意锦州神工半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准,由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式,向特定投资者发行人民币普通股 10,305,736 股,每股发行价格为人民币 29.11 元,募集资金总额为人民币 299,999,974.96 元,扣除各项发行费用合计人民币 3,943,396.22 元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币 296,056,578.74 元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2023]110Z0012 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用金额及当前余额

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金具体使用情况如下:

项　目	金额(元)
募集资金净额	296,056,578.74
减:期初累计已使用募集资金的金额	169,046,798.15
减:本期已使用募集资金的金额	133,246,450.29
减:募集资金结余利息补充流动资金的金额	1,352.54
加:募集资金专项账户银行利息收入	6,238,022.24
募集资金专户余额	0
其中:募集资金专户余额	0
使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额	0

注:根据公司 2026 年 1 月 23 日第三届董事会第十一次会议、2026 年 2 月 10 日 2026 年第一次临时股东会会议,审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将公司募投项目“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”予以终止,公司已于 2026 年 3 月将节余募集资金 13,223.57 万元补充到公司银行存款账户。相关募集资金专户均已于 2026 年 3 月 13 日完成注销,因此截至报告期期末,募投项目已终止且募集资金已使用完毕并销户。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》制定了《募集资金管理办法》(以下简称管理制度),对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定,并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。

2023 年 9 月,公司、国泰海通证券股份有限公司与招商银行锦州分行营业部、中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。监管协议范本不存在重大差异,公司严格按照该监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金存储情况如下:

单位:元

银行名称	银行账号	余额
招商银行锦州分行营业部	416900037710703	已注销,零余额
中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行	0708004329200669624	已注销,零余额
合　计		0

注:上述账户均已于 2026 年 3 月 13 日完成注销

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目情况

募集资金使用情况表详见本报告“附表:2023 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2026 年 1-6 月,本公司不存在先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026 年 1-6 月,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2026 年 1-6 月,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2025 年 10 月 24 日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,使用最高余额不超过人民币 11,000 万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表:

单位:元

银行名称	产品名称	金额	起止期限	年化收益率	是否赎回
中国中金财富证券有限公司辽宁分公司	收益凭证(中金财富安享 1044 号)	40,000,000.00	2025-10-28 至 2026-03-04	1.63%	是
国泰海通证券股份有限公司沈阳黄河南大街证券营业部	收益凭证(君柜宝 2025 年第 18 期)	47,000,000.00	2025-10-28 至 2026-01-29	1.63%	是
国泰海通证券股份有限公司沈阳黄河南大街证券营业部	收益凭证(光睿 25324 号)	23,000,000.00	2025-12-23 至 2026-03-04	1.66%	是

(六)结余募集资金使用情况

不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司前次募集资金投资项目存在以下变更的情况:

根据公司 2026 年 1 月 23 日第三届董事会第十一次会议、2026 年 2 月 10 日 2026 年第一次临时股东会会议,审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将公司募投项目“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”予以终止,并将节余募集资金 13,223.57 万元永久补充流动资金。

2023 年公司决定实施“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”时公司综合考虑了当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素,经过充分论证制定的项目投资计划。但随着半导体行业需求变化,外部环境较决策时已发生明显变化。全球和中国的市场环境较公司规划募投项目时已发生较大变化:一方面,由于全球半导体市场的结构性行情,导致市场整体景气度恢复的时间晚于公司最初预测,该业务的产能利用率未达预期;另一方面,中国本土存储芯片制造厂商发展迅猛,改变了既有的全球产业格局,公司大直径硅材料的直接下游产品硅零部件受到国产化需求带动,实现连续大幅增长,成为公司第二增长曲线,对公司水电气等基础设施配套以及人才梯队建设提出更高要求,需要资金投入。公司经综合考虑近年来市场的供需情况、行业竞争格局变化等因素,审慎决定不再继续投入原募投项目。“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”终止有利于合理利用募集资金,提高资金使用效率,不会对募投项目及公司生产经营活动产生重大不利影响。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表:2023 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

附表:

2023 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				29,605.66	本年度投入募集资金总额				13,324.64	
变更用途的募集资金总额				13,223.57	已累计投入募集资金总额				30,229.32	
变更用途的募集资金总额比例				44.67%						
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1. 集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目	否	21,000.00	20,905.66	20,905.66	101.07	8,257.64	-12,648.02	39.50	见注释	不适用	不适用	是
2. 补充流动资金	否	9,000.00	8,700.00	8,700.00	13,223.57	21,971.68	13,271.68	252.56	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	30,000.00	29,605.66	29,605.66	13,324.64	30,229.32	623.66	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				详见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见“三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见“三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况”之“(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				见注释								
募集资金其他使用情况				不适用								

注:根据公司 2026 年 1 月 23 日第三届董事会第十一次会议、2026 年 2 月 10 日 2026 年第一次临时股东会会议,审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将公司募投项目“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”予以终止,公司已于 2026 年 3 月将节余募集资金 13,223.57 万元补充到公司银行存款账户。

证券代码:688233　　证券简称:神工股份　　公告编号:2026-043

锦州神工半导体股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

锦州神工半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长潘连胜先生召集并主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦州神工半导体股份有限公司 2026 年半年度报告》及《锦州神工半导体股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

(二)审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦州神工半导体股份有限公司 2026 年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

(三)审议通过《关于公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦州神工半导体股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

经审议,董事会同意公司(含子公司,下同)自本次董事会审议通过之日起 12 个月内开展远期外汇交易业务,远期外汇交易开展的外币金额不超过等值 8,000 万美元(含本数),可在此额度内滚动使用。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦州神工半导体股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

(五)审议通过《关于公司收购控股子公司少数股东权益的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

(六)审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据《锦州神工半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》相关规定,因公司实施 2025 年权益分派方案,同意调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格为 13.56 元/股。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦州神工半导体股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

董事潘连胜、袁欣为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

(七)审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)及本激励计划的相关规定,本次激励计划有 17 名首次授予激励对象及 2 名预留授予激励对象因个人原因离职,其已获授但尚未归属的合计 12,200 股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦州神工半导体股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

董事潘连胜、袁欣为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

(八)审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留部分第一个归属期条件成就的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦州神工半导体股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留部分第一个归属期条件成就的公告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

董事潘连胜、袁欣为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

证券代码:688233　　证券简称:神工股份　　公告编号:2026-047

锦州神工半导体股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 限制性股票拟归属数量:304.568 股,其中首次授予部分第二个归属期归属 231.900 股,预留授予部分第一个归属期归属 72.668 股。

● 归属股票来源:锦州神工半导体股份有限公司(以下简称“神工股份”、“公司”或“本公司”)从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。

一、本次股权激励计划批准及实施情况

(一)本次股权激励计划方案及履行的程序

1、本次股权激励计划主要内容

(1)股权激励方式:第二类限制性股票。

(2)授予数量:授予的限制性股票总量为 950.416 股,约占公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)草案公告时公司股本总额 17,030.5736 万股的 0.56%。其中首次授予 803.800 股,约占激励计划草案公告时公司股本总额的 0.47%;预留 146.616 股,约占激励计划草案公告时公司股本总额的 0.09%。

(3)授予价格:13.56 元/股(调整后)。

(4)激励人数:包括在公司(含子公司,下同)任职的董事、高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员,其中首次授予的激励对象共计 295 人,预留授予 54 人。

(5)激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属期安排具体如下:

首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示:

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

预留授予的限制性股票的归属安排如下表所示:

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

(6)任职期限、公司层面业绩考核及个人层面绩效考核要求

①激励对象在归属获授的各批次限制性股票前,须满足 12 个月以上的任职期限。

②公司层面的业绩考核要求:

本激励计划首次授予的限制性股票考核年度为 2024 年-2026 年会计年度,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划授予的限制性股票的业绩考核目标如下表所示:

归属期	业绩考核目标(A)档	业绩考核目标(B)档
	公司归属系数 100%	公司归属系数 80%
首次授予第一个归属期	公司需满足下列两个条件之一: 1、以 2023 年营业收入为基数,2024 年营业收入增长率不低于 30.00%; 2、以 2023 年净利润为基数,2024 年净利润增长率不低于 30.00%。	公司需满足下列两个条件之一: 1、以 2023 年营业收入为基数,2024 年营业收入增长率不低于 18.00%; 2、以 2023 年净利润为基数,2024 年净利润增长率不低于 18.00%。
首次授予第二个归属期	公司需满足下列两个条件之一: 1、以 2023 年营业收入为基数,2025 年营业收入增长率不低于 69.00%; 2、以 2023 年净利润为基数,2025 年净利润增长率不低于 69.00%。	公司需满足下列两个条件之一: 1、以 2023 年营业收入为基数,2025 年营业收入增长率不低于 39.00%; 2、以 2023 年净利润为基数,2025 年净利润增长率不低于 39.00%。
首次授予第三个归属期	公司需满足下列两个条件之一: 1、以 2023 年营业收入为基数,2026 年营业收入增长率不低于 120.00%; 2、以 2023 年净利润为基数,2026 年净利润增长率不低于 120.00%。	公司需满足下列两个条件之一: 1、以 2023 年营业收入为基数,2026 年营业收入增长率不低于 64.00%; 2、以 2023 年净利润为基数,2026 年净利润增长率不低于 64.00%。
预留授予第一个归属期	公司需满足下列两个条件之一: 1、以 2023 年营业收入为基数,2025 年营业收入增长率不低于 69.00%; 2、以 2023 年净利润为基数,2025 年净利润增长率不低于 69.00%。	公司需满足下列两个条件之一: 1、以 2023 年营业收入为基数,2025 年营业收入增长率不低于 39.00%; 2、以 2023 年净利润为基数,2025 年净利润增长率不低于 39.00%。
预留授予第二个归属期	公司需满足下列两个条件之一: 1、以 2023 年营业收入为基数,2026 年营业收入增长率不低于 120.00%; 2、以 2023 年净利润为基数,2026 年净利润增长率不低于 120.00%。	公司需满足下列两个条件之一: 1、以 2023 年营业收入为基数,2026 年营业收入增长率不低于 64.00%; 2、以 2023 年净利润为基数,2026 年净利润增长率不低于 64.00%。

注:上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入;“净利润”指经审计的净利润,但剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

归属期内,公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若各归属期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属,并作废失效。

③激励对象个人层面绩效考核要求:

激励对象的个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施,根据激励对象的绩效考核评分(X)确定归属比例,具体如下:

绩效考核评分	X≥60	X<60
个人层面归属系数	X/100	0%

在公司业绩目标达成的前提下,激励对象当年实际归属的限制性股票数量 = 个人当年计划归属的限制性股票数量 × 公司归属系数 × 个人层面归属系数。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的,作废失效,不可递延至下一年度。

本激励计划具体考核内容依据《公司考核管理办法》执行。

2、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(1)2024 年 8 月 16 日,公司召开第三届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于公司(2024 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日,公司召开第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于公司(2024 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于核实公司(2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(2)2024 年 8 月 17 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《锦州神工半导体股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事张仁寿先生作为征集人,就公司 2024 年第二次临时股东大会审议的公司本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

(3)2024 年 8 月 17 日至 2024 年 8 月 27 日,公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2024 年 8 月 29 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《锦州神工半导体股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(4)2024 年 9 月 2 日,公司召开 2024 年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司(2024 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时,公司就内幕信息知情人与激励对象在《锦州神工半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2024 年 9 月 3 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《锦州神工半导体股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(5)2024 年 9 月 2 日,公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(6)2025 年 8 月 22 日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见。

(7)2026 年 8 月 26 日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2024 年限 制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见。

(二)限制性股票历次授予情况

授予批次	授予日期	授予价格	授予数量	授予人数	授予后本次激励计划剩余限制性股票数量
首次授予	2024年9月2日	13.82 元/股	803.800 股	295	146.616 股
预留授予	2025年8月22日	13.745 元/股	146.616 股	54	0股

注:上述数据口径均以授予当日为准。因公司实施 2024 年年度权益分派,预留授予价格由 13.82 元/股调整为 13.745 元/股。

(三)激励计划各期限制性股票归属情况

截至本公告披露日,公司 2024 年限制性股票激励计划已完成首次授予部分 第一个归属期的归属工作,具体情况如下:

归属批次	归属日	归属价格	归属数量	归属人数	归属后限 制性股票 剩余数量	取消归属数量及原因	因分红送转 导致归属价 格及数量的 调整情况	
首次授 予部分 第一个 归属期	2025年9月22日	13.745 元/股	315.400 股	263	474.720 股	因部分激励对象离职、自愿放弃以及个人绩效考核结果不达标累计作废 13.680 股	2024年年度权益分派实施完毕,授予价格由 13.82 元/股调整为 13.745 元/股	

二、限制性股票归属条件成就的说明

(一)董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2026 年 8 月 26 日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期条件成就的议案》。根据公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的规定,董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件,并根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权,董事会同意公司按照《激励计划》相关规定为符合条件的 307 名激励对象办理首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期限制性股票归属登记事宜,本次可归属数量为 304.568 股。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见。

(二)关于本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个 归属期条件成就的说明

1、进入首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的说明

根据 2024 年限制性股票激励计划的相关规定,首次授予部分第二个归属期 为“自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至授予之日起 36 个月内的最后一 个交易日止”,本次激励计划首次授予日为 2024 年 9 月 2 日,因此本次激励计划首次授予部分第二个归属期为 2026 年 9 月 2 日至 2027 年 9 月 2 日;预留授予部分第一个归属期为“自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止”,本次激励计划预留授予日为 2025 年 8 月 22 日,因此本次激励计划预留授予部分第一个归属期为 2026 年 8 月 24 日至 2027 年 8 月 20 日。

2、限制性股票符合归属条件情况说明

根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权,按照公司《激励计划》的相关规定,公司董事会认为 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期条件已成就,现就归属条件成就情况说明如下:

归属条件	达成情况
1.本公司未发生如下任一情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; (3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,符合归属条件。
2.激励对象未发生如下任一情形: (1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形,符合归属条件。
3.激励对象归属权益的任职期限要求: 激励对象在归属获授的各批次限制